

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年1月12日(12.01.2023)



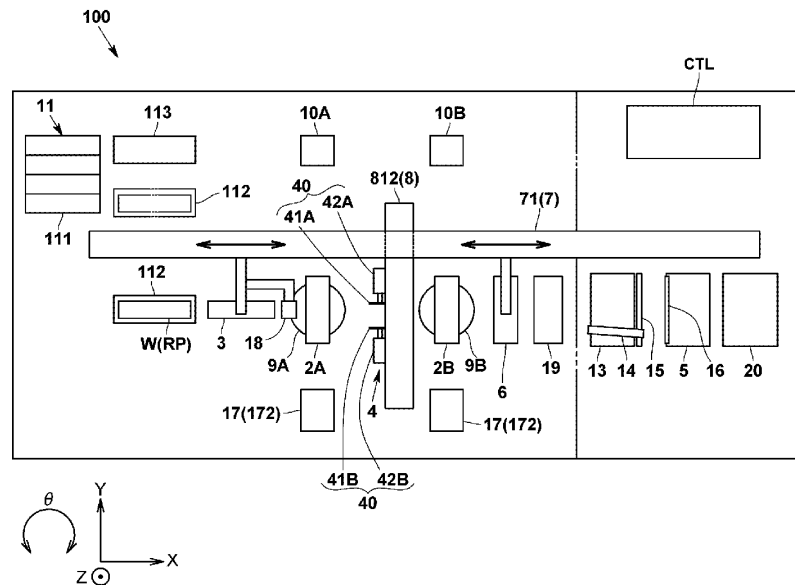
(10) 国際公開番号

WO 2023/281817 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 27/06 (2006.01) B26D 7/18 (2006.01)
B24B 55/06 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/009929
- (22) 国際出願日: 2022年3月8日(08.03.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-114351 2021年7月9日(09.07.2021) JP
- (71) 出願人: T O W A 株 式 会 社 (TOWA CORPORATION) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: 深井 元樹(FUKAI, Motoki); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 Kyoto (JP). 片岡 昌一(KATAOKA, Shoichi); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 Kyoto (JP). 堀 聡子(HORI, Satoko); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 Kyoto (JP). 坂上 雄哉(SAKAUE, Yuya); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 Kyoto (JP). 山本 裕子(YAMAMOTO, Yuko); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 Kyoto (JP).

(54) Title: PROCESSING DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING PROCESSED ARTICLE

(54) 発明の名称: 加工装置、及び加工品の製造方法



(57) Abstract: The present invention simplifies the configuration of a device and reduces the footprint, and reduces the size of an accommodation space for a sliced workpiece. This processing device comprises: processing tables 2A, 2B that hold a sealed substrate W; a first holding mechanism 3 that holds the sealed substrate W to carry the sealed substrate W to the processing tables 2A, 2B; a processing mechanism 4 that cuts and slices the sealed substrate W held on the processing tables 2A, 2B; an accommodating box 5 in which the sealed substrate W sliced by the processing mechanism 4 is dropped

[続葉有]

(74) 代理人: 西村 竜平 (NISHIMURA, Ryuhei);
〒6008441 京都府京都市下京区四条町 3 4 7 番
地 1 C U B E 西烏丸 9 階 Kyoto (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

and accommodated; a second holding mechanism 6 that holds a product P to carry the product P from the processing tables 2A, 2B to the accommodating box 5; a carrying movement mechanism 7 that extends in the arrangement direction of the processing tables 2A, 2B and the accommodating box 5 and has a common transfer shaft 71 for moving the first holding mechanism 3 and the second holding mechanism 6; and a processing movement mechanism 8 that moves the processing mechanism 4 on a horizontal surface in a first direction along the transfer shaft 71 and in a second direction perpendicular to the first direction.

(57) 要約: 本発明は、装置構成を簡素化し、フットプリントを低減するとともに、個片化された加工対象物の収容スペースを小型化するものであり、封止済基板Wを保持する加工テーブル2A、2Bと、封止済基板Wを加工テーブル2A、2Bに搬送するために封止済基板Wを保持する第1保持機構3と、加工テーブル2A、2Bに保持された封止済基板Wを切断して個片化する加工機構4と、加工機構4により個片化された封止済基板Wが落下して収容される収容ボックス5と、製品Pを加工テーブル2A、2Bから収容ボックス5に搬送するために製品Pを保持する第2保持機構6と、加工テーブル2A、2B及び収容ボックス5の配列方向に沿って延び、第1保持機構3及び第2保持機構6を移動させるための共通のトランスファ軸71を有する搬送用移動機構7と、加工機構4を水平面においてトランスファ軸71に沿った第1方向及び当該第1方向に直交する第2方向それぞれに移動させる加工用移動機構8とを備える。